



H3512 导电银浆

H3512 是一款单组分导电银浆。本产品用于 PCB 板导电路路的设计和修复，触点搭接；尤其适用于 LCD，LCM 行业，智能手机、平板等产品显示模块的导电连接。H3512 具有低渗透性，适用于丝网印刷、点胶、手工探针等工艺。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	聚氨酯
外观	银灰色膏体
组分	单组分
固化方式	加热
应用	导电路路的设计和修复

产品优点

- 单组分银胶，易操作
- 优异的导电性和耐候性
- 对ITO、玻璃、PCB等各种基材的附着力优异

产品性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	40000±7000	ASTM D4287, 剪切速率5S
触变指数 TI	7.0±0.5	GB/T 2794 0.5/5rpm
密度 g/ml	2.6±0.1	ASTM 1475
附着力	5B	百格法, ITO/GF/PCB
体积电阻率 $\Omega \cdot \text{cm}$	8×10^{-5}	四线法
可靠性电阻变化率	$\leq 10\%$	40°C/90%RH,1000H
	$\leq 10\%$	60°C,1000H
	$\leq 10\%$	-20-40°C,10cycles



典型的固化特性

推荐固化条件: 130°C/20min。固化条件（时间和温度）因固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而异，应依据客户经验、应用要求而调整。

使用前的注意事项

1. 使用前产品必须达到室温。
2. 如冷藏存储，使用前需将银浆恢复至室温并用行星式搅拌设备分散均匀，避免冷凝水汽进入。
3. 请勿在银胶温度达到 25°C 之前打开容器；打开容器之前，应清除解冻容器上积聚的任何水分。

使用说明

1. 建议使用原装产品。稀释时，请使用专用溶剂 S113 稀释。
2. 请在使用前和 S113 充分搅拌均匀。
3. 由于涂层表面的污染会导致附着力和导电性下降，使用前应进行清洁。
4. 在使用后清洗筛网或容器时，请使用酯基溶剂或 S113。
5. 在操作本产品时，请穿戴防护服并安装全通风系统。

标准包装

- 10g / 支
- 按客户需求包装

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内，应注意防潮、防止污染，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：2-8°C，存储期 12 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。



湖南创瑾科技有限公司总部

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com